

センシング技術・次世代パッケージング (SenTePack) コンソーシアム
第2回研究会 プログラム

- 1、開催日時：2026 年 9 月 25 日(金) 13：30~18：00
- 2、開催方式：会場開催
- 3、開催会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11 階 第1会議室
- 4、会場アクセス：<https://www.aist.go.jp/waterfront/ja/access/index.html>
- 5、プログラム：

13：30~13：35 研究会開会挨拶 SenTePack 会長 植村 聖

13：40~14：30

講演1「機械学習×構造解析シミュレーションに関するご講演（仮題）」

慶応義塾大学 准教授 村松 眞由

14：30~15：00

講演2「応力発光を利用したひずみセンシング技術（仮題）」

産総研 センシング技術研究部門 研究グループ長 藤尾 侑輝

15：00~15：40 ワーキンググループ意見交換会（1回目）

15：55~16：25 ワーキンググループ意見交換会（2回目）

16：35~17：25

講演3「半導体パッケージング技術動向に関するご講演（仮題）」

株式会社日立製作所 日立製作所 研究開発グループ

グリーン&コネクティブイノベーションセンタ 主管研究員 植松 裕

17：25~17：55

講演4「光計測技術を応用した精密研磨後の潜傷検出技術（仮題）」

産総研 センシング技術研究部門 研究グループ長 坂田 義太郎

17：55~18：00 研究会閉会挨拶 SenTePack 副会長 吉田 学

18：15~ 懇親会

お問い合わせ先：

SenTePack 事務局

国立研究開発法人産業技術総合研究所センシング技術研究部門

e-mail：M-SenTePack-ml@aist.go.jp